

社発第 T-573 号  
2019 年 2 月 6 日

貸借取引参加者  
代 表 者 殿

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 小 林 英 三

貸借取引対象銘柄の追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今般当社は標記の件を下記のとおり実施することといたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 貸借銘柄の追加

(1) 対象銘柄

(東京証券取引所市場分)

日本プロセス(株) 株式 (9651)

(2) 実施日

2019 年 2 月 7 日 (木) (約定日)

2. 貸借融資銘柄の追加

(1) 対象銘柄

(名古屋証券取引所市場分)

(株)コモ 株式 (2224)

(2) 実施日

2019 年 2 月 7 日 (木) (約定日)

以 上